MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

SiC MOSFETチップの取り扱いガイド

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

PA7-G-260809-*-013

SiC MOSFETチップの取り扱いガイド

・不適切な輸送・保管・実装は、チップ損傷や信頼性低下の原因となる可能性があります。
・ウエハおよびチップは、当社工場からの出荷後、パッケージへの搭載・検査完了まで、各工程で適切に取り扱ってください。

↓ 当社工場から出荷

輸送	■下記の事項を遵守しない場合には、チップの損傷やインバータ動作時の誤動作や故障の原因となる恐れがあります。 ・輸送用段ボール箱は正しい向きで取り扱うこと ・箱を投げたり落としたりしないこと ・箱を濡らさないこと



↓

保管	■下記の事項を遵守しない場合には、モジュール実装時の不具合や性能/信頼性が損なわれる恐れがあります。 ・水濡れ、振動、衝撃に十分注意して保管すること ・適切な環境で保管すること※弊社推奨保管条件 5℃≦Ta≦30℃, 45%≦RH≦70% ・開発後は窒素雰囲気で保管しできるだけ早く使用すること ・保管期限を超えたチップはお客様で十分な品質確認を実施し使用可否を判断すること ・静電気を帯びやすい容器を輸送や保管に使用しないこと



余剰ウエハ・チップは再度保管

↓

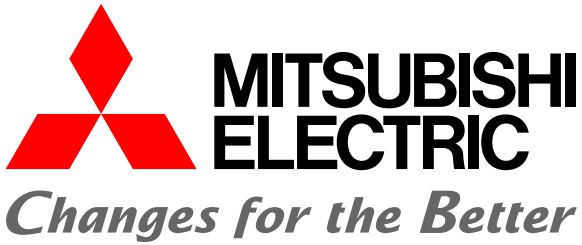
組立 検査	■下記の事項を遵守しない場合には、重大な事故につながる恐れがあります。 ・チップおよび搭載モジュールやインバータは、高湿度環境（結露を含む）、有機溶剤、腐食性ガス、爆発性ガス、微粒子、または腐食性物質にさらさないこと ■下記の事項を遵守しない場合には、人体や段ボール箱に帯電した静電気、またはチップの異電極間に印加される過大な電圧によってチップやモジュールが損傷する恐れがあります。 ・チップやモジュールの電極端子には絶対に素手で触らないこと ・モジュール実装時には装置および人体を接地すること ・作業台やその周辺の床に導電性マットを敷くなどの対策を実施すること ・チップやモジュールが帯電した場合は速やかに放電すること ・チップのゲート-ソース間がオープンの状態でドレイン-ソース間に電圧を印加しないこと



↓ モジュール状態で次工程へ流動

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

© Mitsubishi Electric Corporation


MITSUBISHI
ELECTRIC
Changes for the Better